

8414 ACF

製品案内

異方導電性 熱活性接着テープ



製品の説明

テサHAF 8414ACFは異方導電性を持つ熱活性接着フィルムで、導電性粒子を主成分であるコポリアミドに混合した製品です。

- フィルムの厚み方向にのみ導電性がある
- 1工程で機械的な固定と電気的な導通が一度ですみます
- 従来の接触型の実装機で作業が可能 (スマートカード製造の場合)
- PVC, ABS, PET, PCの樹脂カード及び金属、アルミに適用可能
- 耐候性に優れる

特徴

- Chip module bonding and electrical connectivity in one step
- Good workability on all common implanting lines
- Suitable for PVC, ABS and PC cards (Dual Interface (D.I.) and contactless cards)
- Suitable for silver ink substrates and wire antenna
- Mean particle diameter: 40 µm

用途

- PVC、ABSカードに (DI)
- 銀インク表面に (RFID)

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|--------|------|
| • 基材 | 無し | • ライナー | グラシン |
| • 粘着剤 | コポリアミド | • 色 | 半透明 |

備考

Processing:

Please note that optimal parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies, antenna material or chip-modules as well as individual customer requirements. The bonding time depends on the heat transition of the used substrates. Additionally we recommend a cooling step directly after the bonding step. Thereby pressure should be applied until film temperature decreases below softening temperature (approx. 110 °C).

The following data are recommendations for the initial set-up of machine parameters.

1. Pre-lamination:

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08414>



8414 ACF

製品案内

備考

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. An accurate pre-lamination is in particular important for tesa HAF® 8414 in order to ensure a good adhesion and a good conductivity inside of the final product.

Machine setting:

- Temperature 130 - 150 °C
- Pressure 3 - 4 bar
- Time 2.5 m/min.

2. Conductive Bonding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die-cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of the implanting line, single step or multiple step process can be used. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single step process - Machine setting:

- Temperature¹ 160 – 220 °C
- Pressure 65 - 130 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 130N/module
- Time 2 x 0,7 s. / 3 x 0.5 s.

¹Temperature recommendations refer to what can be measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- PVC 180 – 190 ° C
- ABS 180 – 190 ° C
- PET 190 – 200 ° C
- PC 200 – 220 ° C

To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry. Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



8414 ACF

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08414>